

无锡尚积半导体科技股份有限公司
《年新增研发 20 台半导体薄膜沉积设备项目》
竣工环境保护自主验收专家意见

根据国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第 682 号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）等文件要求，2026 年 6 月 4 日，无锡尚积半导体科技股份有限公司（以下简称该公司）在公司内组织召开了“年新增研发 20 台半导体薄膜沉积设备项目”环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、技术服务机构（无锡市科泓环境工程技术有限责任公司）等单位代表共 5 人，会议邀请 2 名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告表及批复，踏勘了工程现场，听取了建设单位关于项目基本情况介绍，技术服务机构对于竣工验收监测报告内容的介绍，经认真讨论形成如下专家意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

无锡尚积半导体科技股份有限公司成立于 2021 年 6 月，租用无锡生命科学产业发展有限公司 35-312 号厂房，主要致力于平台软件和操作系统、化合物干法刻蚀腔体、与化合物工艺相关的辅助工艺腔体的自主设计研发。

现由于国内化合物和 MEMS 芯片下游客户对 CVD 腔体有更高均匀性的要求，企业拟新增投资 300 万元，增加租赁无锡生命科学产业发展有限公司 35-321 号厂房，本项目建成后工艺于两个厂区内进行，于 35-321 号厂房进行刻蚀设备组装，于 35-312 号厂房进行刻蚀设备调试验证。调试验证完成后的样机则交由下游客户（中国电子科技集团有限公司、龙腾半导体股份有限公司等十几家半导体相关单位）进行

进一步推广使用。本项目建成后，年新增研发 20 台半导体薄膜沉积设备。

该项目于 2026 年 2 月 4 日、5 日对本项目配套的环保设施进行了现场监测，验收监测单位为江苏国舜检测技术有限公司。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。

2、建设过程及环保审批情况

无锡尚积半导体科技股份有限公司委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制了项目的环境影响报告表，项目于 2025 年 6 月 30 日通过无锡市数据局的批复同意开工建设（审批文号：锡数环许〔2025〕7106 号）。本次验收项目于 2026 年 1 月建成开始试运行。

无锡尚积半导体科技股份有限公司已根据规定进行了国排登记，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

本次验收项目实际投资 300 万元，其中环保投资 50 万元，环保投资占总投资额的 16.67%。

4、验收范围

本次验收项目主要包括无锡尚积半导体科技股份有限公司《年新增研发 20 台半导体薄膜沉积设备项目》建设内容及配套的水、气、噪声和固体废物的污染防治措施落实情况。

二、工程变动情况

对照环评、批复要求、本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目已实施了雨污分流。本项目产生的废水及去向如下：35-312 号厂房和 35-321 号厂房生活污水经化粪池预处理后，与冷却废水通过

厂区污水接管口排入新城水处理厂集中处理。厂区设有2个污水接管口和2个雨水排放口。

2、噪声

本项目噪声源主要来自压缩机等。通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

3、固体废弃物

3.1 固体废弃物种类、处置去向

本次验收项目危险废物有：废吸附剂等，均委托有资质单位处置。

本次验收项目一般固体废弃物有：废靶材、废芯片等由专业单位回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。

3.2 环评和批复要求及落实情况

危险固体废弃物须交由有资质单位处置。须建立规范的危险固体废弃物管理台账（内容包括危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器、日期等）。须及时进行危险固体废弃物申报登记。危险固体废弃物委托处置须履行报批和转移联单等手续。

危险固体废弃物和一般固体废弃物已分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。危险固体废弃物暂存场所具备防雨、防渗、防漏设施（含挥发性物质的废物需密闭），并具有规范的危险废物识别标志、视频监控、照明设施和消防设施。已根据危险固体废弃物的种类和特性进行分区、分类贮存。

4、其他有关情况

全厂生产车间外周边50米范围内，未新建居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标。

本次验收项目废气排放口、雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废弃物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置了标志牌。

四、环境保护设施监测结果

1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷达到实际生产规模 75%，符合验收监测技术规范要求。

2、废水

污水接管口监测结果表明：35-312 号厂房和 35-321 号厂房废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和 pH 值均满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中 A 级标准限值。

3、噪声

根据验收监测结果：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类区排放标准。

4、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目水污染物排放总量符合环评、批复要求。

五、工程建设对环境的影响

验收监测资料表明，该项目验收监测期间，废水、废气主要污染物达标排放；无组织废气浓度限值及厂界噪声均达标；项目固体废物堆场已落实，产生的各类固体废物均进行合法有效处置。环评报告设置的卫生防护距离范围内无环境敏感目标。满足环评报告营运期间大气环境影响分析要求。

六、验收结论

1.对照无锡尚积半导体科技股份有限公司验收监测资料和环评报告表及审批意见，项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、主要设备及原辅材料等均未发生重大变化。

2.项目涉及的废气、废水、噪声和固体废物污染防治设施基本执

行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场踏勘情况，结合验收监测资料，项目满足环评文件及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

3.完善验收监测报告相关内容，执行信息公开制度后，可将环保竣工自主验收资料通过生态环境部网站备案公示。

七、后续要求

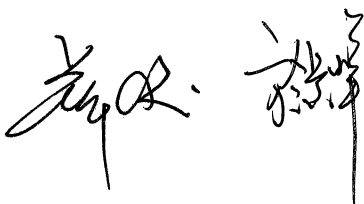
1.加强公司废水、废气、固废、噪声污染防治设施的日常维护管理，确保稳定连续正常运行；

2.定期监测主要污染物排放情况，确保长期、稳定、达标排放，满足环评及审批文件要求。

八、验收人员信息

见附件《验收签到表》。

专家签字：



(建设单位盖章)

2026年6月4日

无锡尚积半导体科技股份有限公司
“年新增研发 20 台半导体薄膜沉积设备项目”竣工环保验收会议签到表

评审时间：2026 年 6 月 4 日

姓名	单位	职称 职务	联系方式	身份证号码
马建群	无锡尚积半导体科技股份有限公司	经理	15251677127	320203198712300919
周飞宇	无锡尚积半导体科技股份有限公司	工程师	1377117495	32020219980401351X
袁政	无锡中清之源环境服务有限公司	高工	(3906179355	32092319760113053
袁宗峰	无锡市环境科学学会	高工	13656172570	13060319720920121X
徐晓华	无锡中清环境工程检测队有限公司	技术员	18961501170	320282198709103229